

	<p>上海涌贝资管、深圳翼虎投资、上海重阳投资、上海长见投资、深圳前海矩阵投资、润晖投资、友邦投资、华泰资管、开域资本(新加坡)、东方证券资管、财通证券资管、东证融汇资管、国泰君安资管、招商证券资管、深圳远信投资、华海财保、百年保险资管、德懿禾资管、觅渊投资、柏骏资本、长城财富保险资管、合众资管、招商信诺资管、华安财保资管、大家资产、中国人寿资管、成都欣至峰投资、银河源汇投资、LIBRARY GROUP、广西赢舟管理咨询、中证鹏元资信评估、绿脉控股、均瑶国际、招商银行、中国建设银行、复星集团、野村国际(香港)、瑞士银行、中金公司、中信证券、开源证券、中银国际证券、中信建投证券、东吴证券、信达证券、国联证券、国海证券、平安证券、长城证券、山西证券、上海证券、华鑫证券、第一创业证券、华安证券、方正证券、西部证券、国金证券、西南证券、诚通证券、中原证券、国泰君安证券、光大证券、民生证券、财通证券、招商证券、上海申银万国证券、东方财富证券、安信证券、兴业证券、汇丰前海证券、德邦证券、野村东方国际证券、中天国富证券、华福证券、华泰证券、东北证券、浙商证券、首创证券、中国银河证券、中泰证券、国开证券、华金证券、长江证券、海通证券、中山证券、东方证券、红塔证券、国新证券、中邮证券、凯基证券、东吴证券(香港)、民生证券、广发证券、华创证券、个人投资者(排名不分先后)</p>
<p>时间</p>	<p>2024年1月26日 17:30</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：王渝、陈小曼、陈卓璜</p>

投资者关系活
动主要内容介
绍

一、公司 2023 年度业绩预告情况

公司2023年整体盈利能力有所下滑，公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润21,000万元至24,000万元，同比下滑53.34%至60.05%；扣除非经常性损益后的净利润为4,000万元至5,800万元，同比下降85.34%至89.98%。

公司业绩较去年同期变动的主要原因为持续推进封装基板业务的投资扩产，并加大人才引进力度和研发投入，成本费用负担较重，对净利润造成较大拖累，其中，CSP封装基板项目尚处于产能爬坡阶段，受制于订单获取不足及产能利率不达预期，全年亏损约0.67亿元；FCBGA封装基板项目报告期内尚处于客户认证、打样和试产阶段，人工、材料、能源、折旧等费用合计投入约3.70亿元。

二、FCBGA封装基板项目的进展情况

公司珠海FCBGA封装基板项目部分大客户的技术评级、体系认证、可靠性验证均已通过，预计2024年第一季度进入小批量生产阶段，目前已有少量样品订单收入，金额较小。

广州FCBGA封装基板项目设备安装调试已基本完成，已进入内部制程测试阶段。

三、CSP封装基板项目及发展预期介绍

公司CSP封装基板现有产能为3.5万平方米/月，其中广州基地产能为2万平方米/月，已满产；广州兴科珠海基地产能为1.5万平方米/月，产能利用率超过50%。

存储芯片行业是公司CSP封装基板领域最大的下游市场，收入占比约2/3，指纹识别芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片等其他相关领域占比约1/3。自2022年第四季度开始，CSP封装基板订单不足，至2023年5月份开始订单有所回暖，未来CSP封装基板项目的经营效益主要取决于整体需求复苏的情况。

四、公司传统PCB业务情况介绍

公司样板、小批量板业务客户集中度低，公司客户多为下游多个行业领先企业或龙头企业，客户所涉行业较广，不依赖单一行业、单一客户，受下游大客户或单一行业周期、经济周期影响小。业务产品下游应用占比如下：通信约占1/3，服务器、安防各占15%~20%，工控、医疗各占10%左

右，其他行业约占15%。

宜兴批量板主要为8层以上高、多层线路板，主要应用于5G、光模块、服务器、安防等领域，已在通信和服务器领域的大客户端实现量产突破，但受制于下游需求不振及竞争加剧，毛利率水平有所下降。

五、北京兴斐电子有限公司目前情况

北京兴斐电子有限公司已于2023年7月纳入公司合并范围，并已完成对核心团队的股权激励，目前资产、业务等整合工作已全面展开，业务拓展工作稳步推进，除三星和国内主流手机品牌客户之外，FCCSP基板和采用BT材质的FCBGA基板已实现批量交付，应用于高端光模块领域的类载板认证工作也已启动并顺利开展。

六、公司国产化相关工作介绍

目前公司正配合大客户验证部分国产设备、材料，CSP封装基板项目的国产化率比FCBGA封装基板项目的会相对更高一些，但核心设备、材料基本仍是进口的，一方面是客户验证的原因，另一方面是国产设备、材料确实还存在差距，随着整个产业链能力的逐步提升及突破，行业国产化替代占比会逐步提升。

七、公司未来发展方向

公司仍坚定加码数字化转型和高端封装基板战略。

传统PCB领域的数字化转型稳步推进，通过数字化转型实现提质降本增效，在质量、技术、交期等环节提升竞争力，实现平稳增长。

半导体业务方面，CSP封装基板将在现有产能满产后启动扩产计划；FCBGA封装基板项目持续加注，客户认证、良率提升及产线建设稳步推进。

附件清单

无

日期

2024年1月26日